



LEICA **SUMMICRON-M** 1:2/66

テクニカルデータ



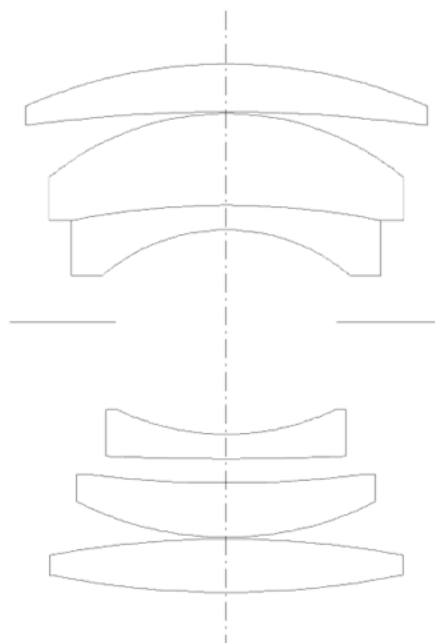
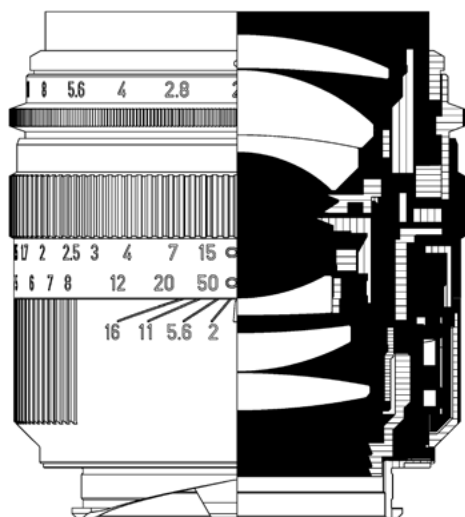
レンズ	Leica Summicron-M 1:2/66
製品コード	11099
画角 (対角/水平/垂直) 35 mm判 (24 × 36 mm)	36.3°/30.5°/20.6°
光学設計 レンズ構成 入射瞳位置 合焦範囲	5群6枚 31.40mm 1m～無限遠
距離設定 スケール 最小撮影面積 最大撮影倍率	メートル(m)/フィート(ft)表記 35 mm判換算: 321 × 481 mm 1:13.4
絞り 設定方法 最小絞り 絞り羽根枚数	クリックストップ絞り、目盛り間の中間値設定可 16 9
レンズマウント	ライカMマウント
物体認識	カメラのファームウェアバージョン2.6.3以降、Mレンズリストから手動で選択可能
フィルター取り囲部	E49
レンズフード	ねじ込み式
寸法 長さ 直径	約60.1mm 約60mm
重量	約456g



LEICA **SUMMICRON-M** 1:2/66

図面

断面図

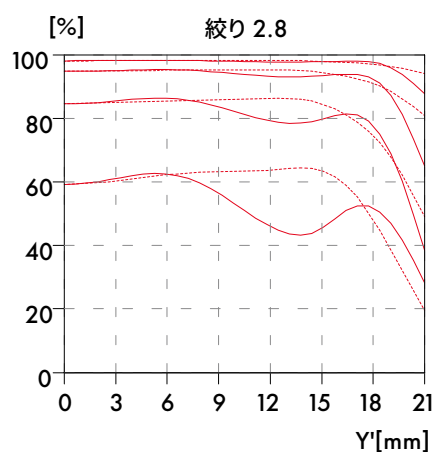
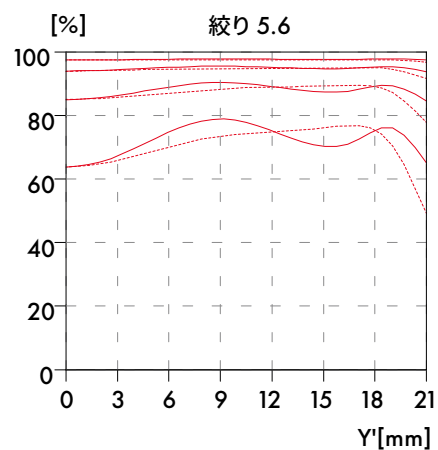
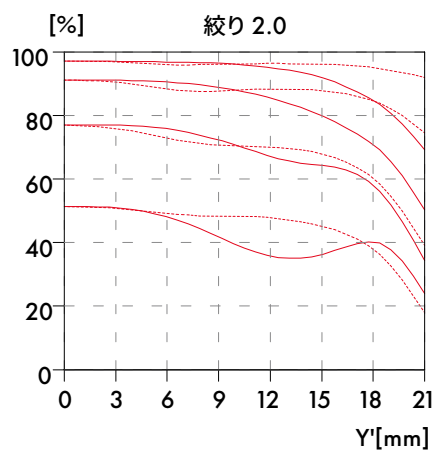


縮尺 1:1



LEICA SUMMICRON-M 1:2/66

MTFチャート



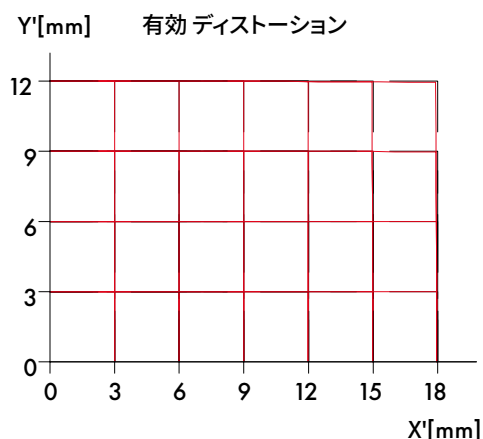
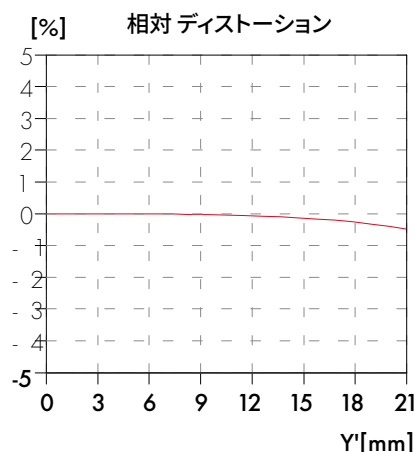
MTF曲線

MTFは開放絞り、および長焦点距離（無限遠）のf/2.8とf/5.6についてそれぞれ示されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40 lp/mmのタンジェンシャル構造（破線）とサジタル構造（実線）の白色光の下でのコントラストです。5および10 lp/mmは比較的大きな被写体構造に対するコントラスト特性を示し、20および40 lp/mmは細部および極めて細かな被写体構造に対する解像度を示しています。

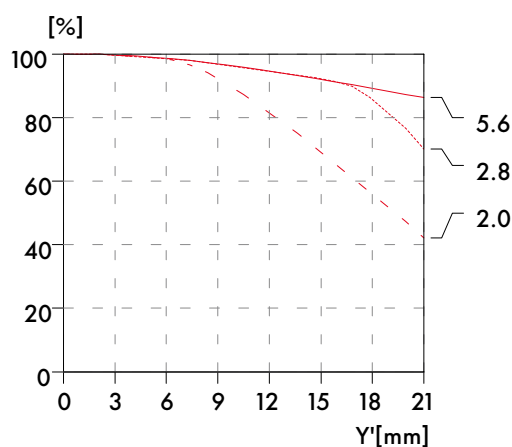


LEICA SUMMICRON-M 1:2/66

ディストーション



ビネッティング



—— サジタル構造
----- タンジェンシャル構造

ディストーション

ディストーションとは、対象物の高さや画像の縮尺から算出した像の高さの理論値と実際の像の高さを比較した偏差です。相対ディストーション値とは像の高さの理論値と実際の数値の偏差をパーセント表示したものです。像高21.6 mmは、画面中心から画面の四隅（画面サイズ 24 mm × 36 mm）までの放射方向の距離を表します。有効なディストーション値をグラフ化すると、実際の経路と画面内の水平方向と垂直方向の線の曲率が明確に表されます。

ビネッティング

ビネッティングとは画像の隅の方向に行くにつれて画像の明るさ（照度）が次第に減少していくことです。（口径食とも言い、画面の角が暗くなる）グラフでは明るさの減少が画像の高さごとにパーセント表示で示されています。100%の状態ではビネッティングは発生しません。